

エレクトロニクス部会ニュース

Vol. 7, No. 3 (通巻 No. 37)

平成 26 年 9 月 2 日(火)

部会ニュース Vol.7, No.3 (通巻 No.37) をお届けします。内容は平成 26 年度第 3 回幹事会の議事概要と次回幹事会のご案内です。

第 3 回幹事会の主な議事内容は、平成 26 年度シンポジウム、第 46 回秋季大会、ホームページ改善、等についてです。また、大阪府立大学 嘉田 守宏氏の御講演がありました。

(1) 平成 26 年度第 3 回幹事会

日時：8 月 29 日(金) 14:00-17:30

場所：住友ベークライト(株)会議室

出席者：羽深、横澤、近藤(司会)、宇井、老田、荻野、押部、谷口、はばき、石井、嘉田、及川

主な議事内容は次の通りです。

1. 平成 26 年度シンポジウム

シンポジウム：「微小銅めっきのメカニズムとその応用」

日時：平成 26 年 9 月 11 日(木) 12:00-17:40

場所：東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール

詳細は資料 1 を御覧下さい。

2. 第 46 回秋季大会

標記大会が平成 26 年 9 月 17 日(水) - 19 日(金)、九州大学伊都キャンパスで開催されます。「エレクトロニクス材料とプロセス」のセッションは 9 月 17 日(水) 9:00 - 17:20 の予定です。招待講演は次の 2 件

銅めっき反応と添加剤による穴埋めつき (阪府大)横井昌幸氏

高純度微小銅めっきと抵抗減少機構 (茨城大)大貫 仁氏

で、一般講演は 19 件です。詳しくは <http://www3.scej.org/meeting/46f/> を御覧下さい。ご参加の程お願い申し上げます。

3. 年鑑

化学工学 10 月号掲載予定の「12. エレクトロニクス・実装プロセス工学」のゲラ刷りが配布されました。内容は 12.1 半導体結晶プロセス、12.2 エレクトロニクスデバイスと新材料、12.3 リチウムイオン 2 次電池材料です。

4. 本部会ホームページ

本部会のホームページは、部会ニュース、シンポジウム、その他の行事、共催行事、部会役員名簿、部会法人会員、法人賛助会員等について、必要がある度に必ず更新することにしました。

なお、化学工学会本部のホームページ p.1 の「お知らせ」の次に「支部・部会からのお知らせ」という欄を新しく作るということです。

5. 講演

大阪府立大学 大学院工学研究科 嘉田 守宏氏より「R & D overview of 3D integration technology using TSV in Japan」と題する講演をして頂きました。講演後活発な質疑討論が行われました。



(2) 平成 26 年度第 4 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。どうぞご出席ください。

1. 日時：平成 26 年 11 月 13 日(木) 14:00～17:30
2. 場所：住友ペークライト㈱会議室
3. 議題：来年度シンポジウム
化学工学会第 80 年会 等

(3) 行事予定

1. シンポジウム「微小銅めっきのメカニズムとその応用」

日時：平成 26 年 9 月 11 日(木)
場所：蔵前会館 ロイヤルブルーホール

2. 化学工学会第 46 回秋季大会

日時：平成 26 年 9 月 17 日(水)－19 日(金)
場所：九州大学伊都キャンパス

3. 「第 21 回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム (Mate 2015)

日時：平成 27 年 2 月 3 日(火)－4 日(水)
場所：パシフィコ横浜 会議センター5 階

4. 化学工学会第 80 年会

日時：平成 27 年 3 月 19 日(木)－21 日(土)
場所：芝浦工大豊洲キャンパス

資料 1

シンポジウム「微小銅めっきのメカニズムとその応用」

協賛：電子 SI 連絡協議会(ESIC)、表面技術協会、エレクトロニクス実装学会(JIEP)、日本電子回路工業会(JPCA)

銅は銀に次ぐ低抵抗金属であり、電子機器、医療機器、自動車等の配線材料/接点材料に多用されている。1997 年の IBM の銅ダマシメッキの発表以来、急速にその多彩な応用が広まった。塩素や複数個の高分子の添加剤を用いるとリフローしなくても、微小な孔に埋まるため非常に汎用性が広い技術である。しかしながら塩素や複数個の高分子の添加剤を用いるとなぜ微小な孔が埋まるのか明確にはされていない。本シンポジウムでは大阪府立大学で最近急速に理解が進んだ

その本質メカニズムに迫る。

- ・日 時 : 2014 月 9 月 11 日(木) 12:30-17:40 懇親会 17:50-19:00
- ・会 場 : 東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール
東急目黒線・大井町線大岡山駅下車徒歩1分
〒152-0033 目黒区大岡山 2-12-1 <http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/index.html>

参 加 費 : 当日受付にてお支払い下さい。

大学関係者・学生	無 料
エレクトロニクス部会個人会員、部会法人会員(賛助会員を含む)会社の社員	2,000 円
上記以外の化学工学会会員	5,000 円
協賛学会等の会員	5,000 円
その他 一般	10,000 円

懇親会(17:50-19:00) 3,000 円

講演

12:35-13:25	「微小銅めっきの一価銅の役割」	大阪府立大学	近藤和夫氏
13:25-14:05	「微小銅めっきの添加剤の役割」	大阪府立大学	横井昌幸氏
14:05-14:45	「高純度微小銅めっきと抵抗減少機構」	茨城大学	大貫 仁氏
14:45-15:00	休憩		
15:00-15:40	「微小銅めっきの奥野製薬の応用」	奥野製薬工業(株)	大塚邦顕氏
15:40-16:20	「微小銅めっきの JCU の応用」	株JCU	君塚亮一氏
16:20-17:00	「マスクメロン銅箔の応用」	三井金属鉱業(株)	井上尚光氏
17:00-17:40	「バイオテンプレートへの微小めっき」	東京工業大学	鎌田香織氏

オーガナイザー：大阪府立大学 近藤和夫、日立化成 中村英博

下記の事項を記入の上、お申し込み下さい。

- 1.氏名 (フリガナ要)
- 2.勤務先住所 (所属部署まで)
- 3.メールアドレス
- 4.Tel/ Fax
- 5.懇親会参加の有無
- 6.会員資格 (大学関係者、エレクトロニクス部会個人会員、エレクトロニクス部会法人会員(賛助会員を含む)、化学工学会会員、電子 SI 連絡協議会会員、表面技術協会会員、エレクトロニクス実装学会会員、日本電子回路工業会会員、その他一般)

* 申込先 : E-Mail : electro@chemeng.osakafu-u.ac.jp 大阪府立大学近藤研究室・山本

Tel : 072-254-9304